

# 聯茂電子

2023年第三季營運成果

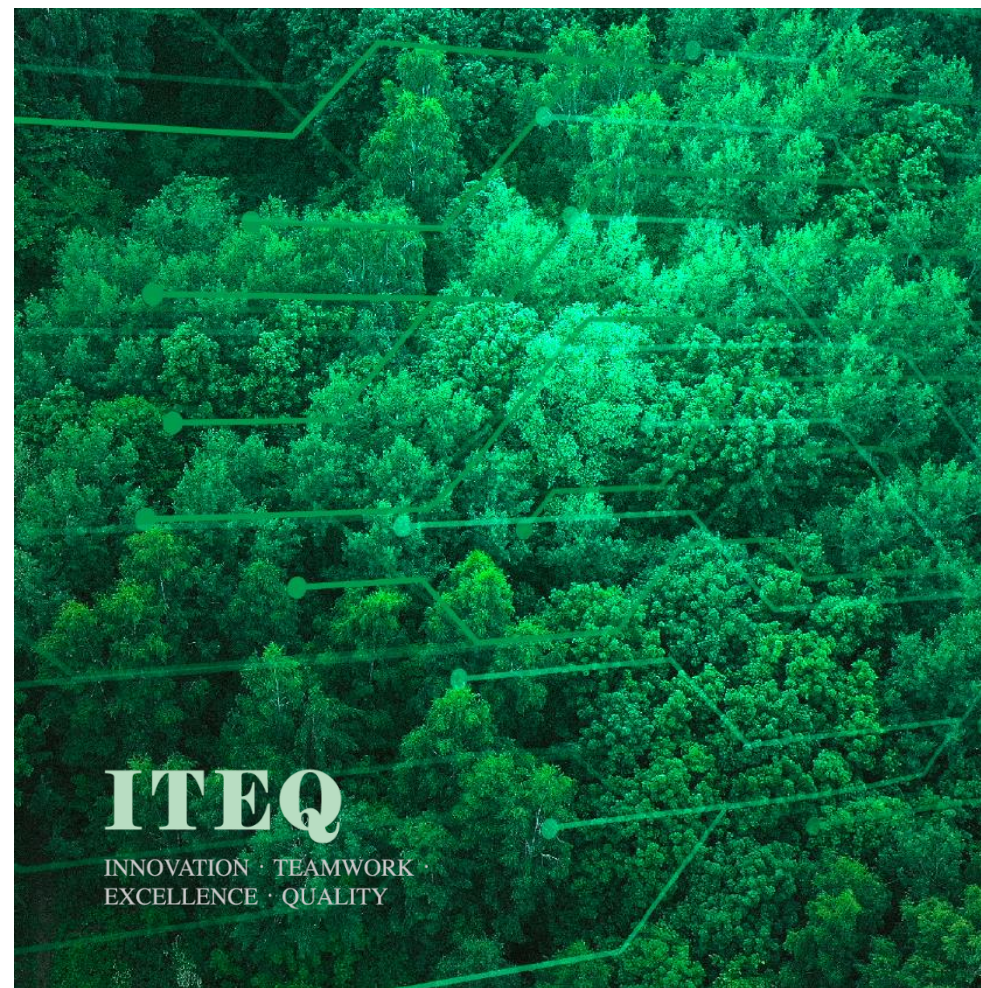
ITEQ

INNOVATION. TEAMWORK. EXCELLENCE. QUALITY

November 2023

# 免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。





## 公司簡介



成立日期  
1997年4月10日



總部  
臺灣新竹縣



實收資本額  
NT\$ 36.3億



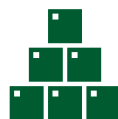
員工  
約4,000人



董事長  
陳進財

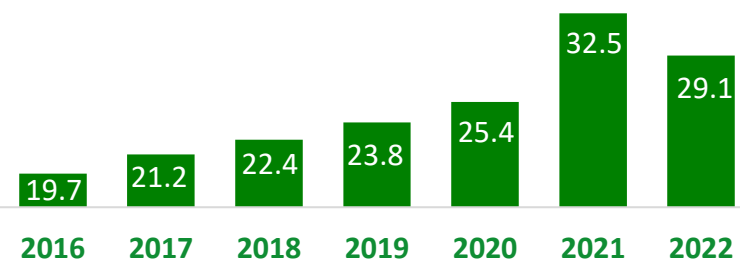


執行長  
蔡馨曄

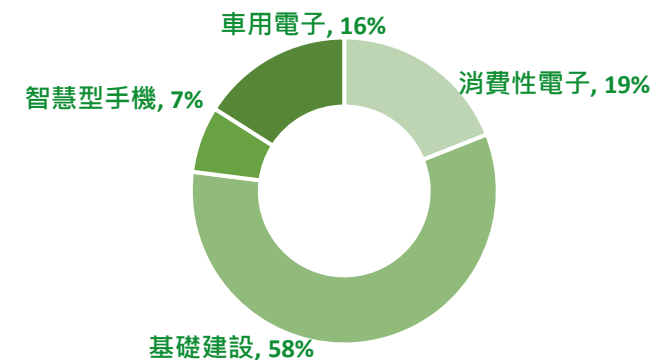


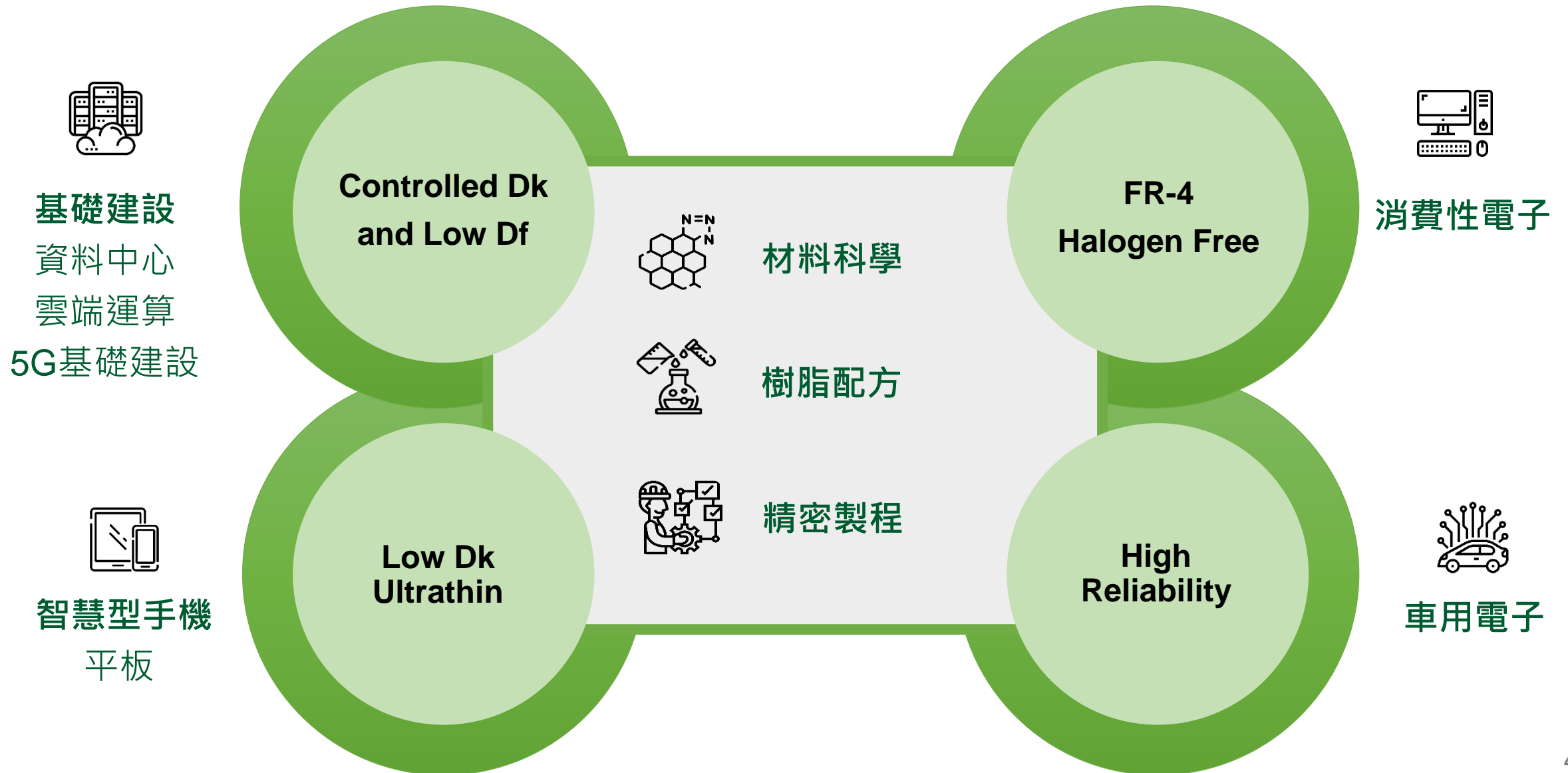
主要產品  
銅箔基板 (CCL) & 膠片 (PP) | 多層壓合代工 | 軟性銅箔基板

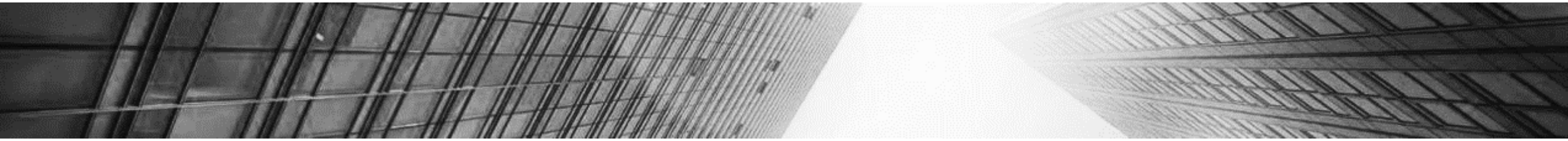
### 營收 (NT\$ 十億元)



### 產品應用別營收 (2022全年)







# 3Q23 營運成果

---

**ITEQ**

**ITEQ**

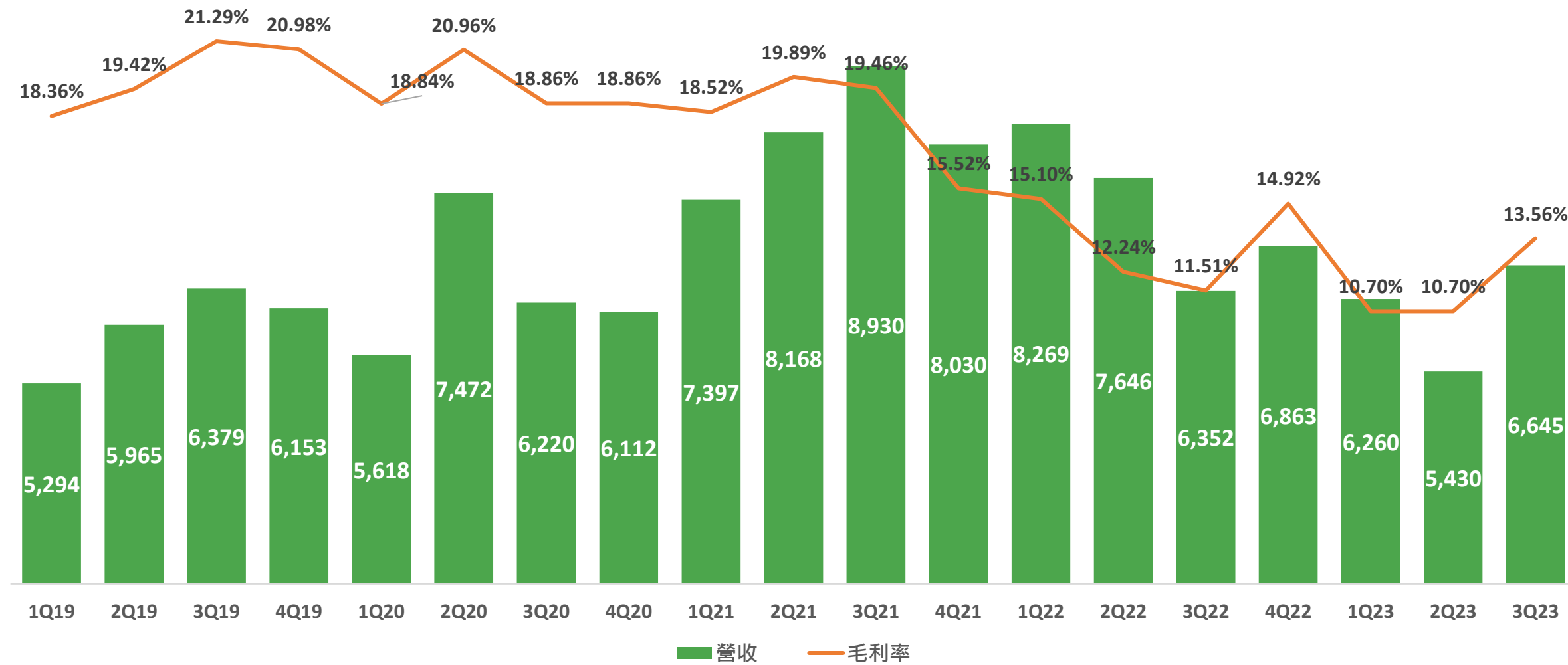
INNOVATION • TEAMWORK •  
EXCELLENCE • QUALITY

# 3Q23 損益表

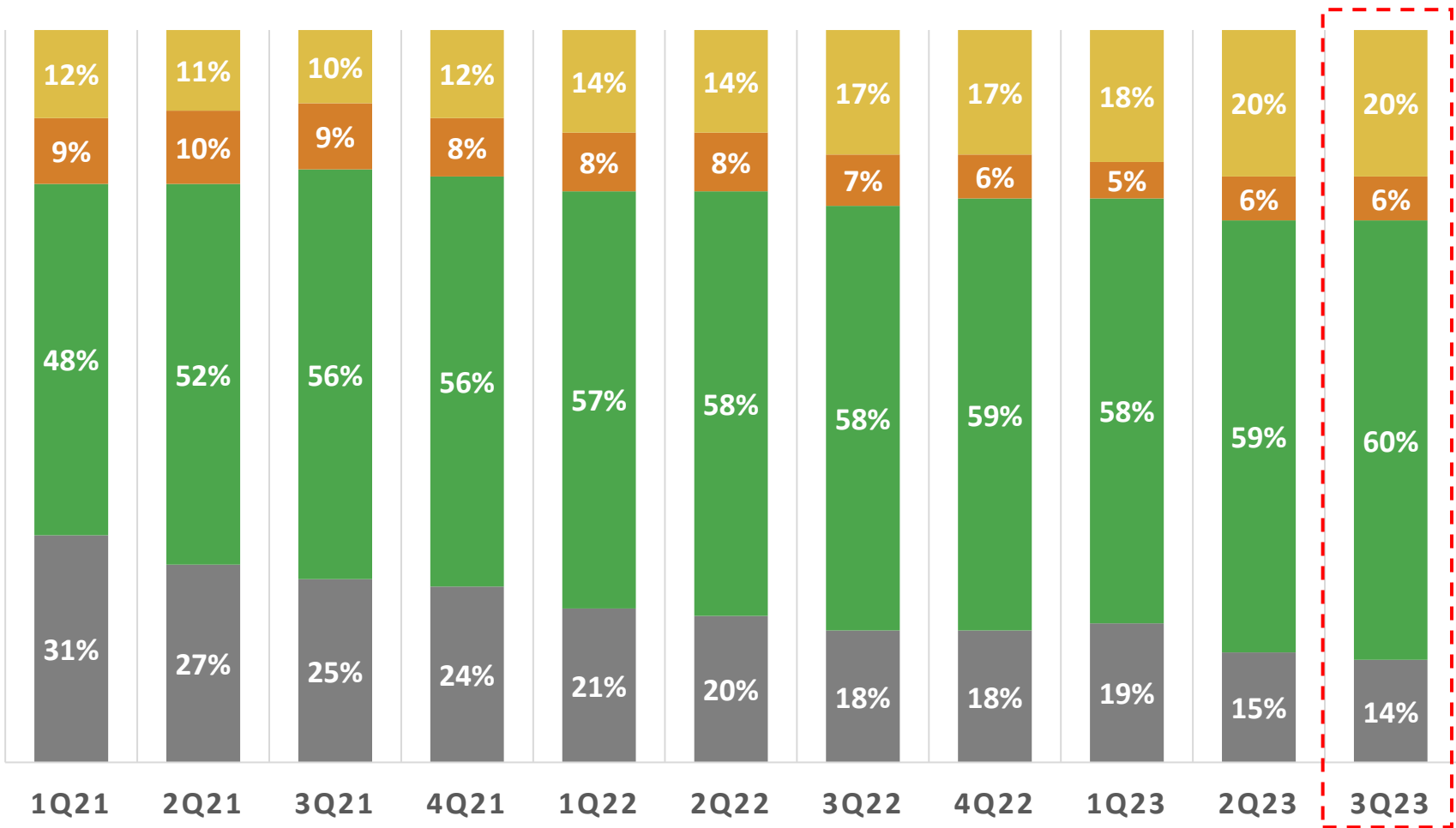
NTD/百萬元	3Q23	2Q23	3Q22	QoQ	YoY
營業收入	6,645	5,430	6,352	22.4%	4.6%
營業毛利	901	581	731	55.1%	23.3%
營業費用	511	523	382	-2.3%	33.8%
營業利益	390	58	349	572.4%	11.7%
營業外收入及支出	(4)	23	13		
稅前淨利	386	81	362	376.5%	6.6%
所得稅費用	151	40	85		
歸屬於母公司之淨利	235	42	277	459.5%	-15.2%
每股盈餘(NTD)	0.65	0.11	0.74	490.9%	-12.2%
<b>重要財務比率</b>					
毛利率	13.56%	10.70%	11.51%		
營業費用率	7.69%	9.63%	6.01%		
營業利益率	5.87%	1.07%	5.49%		
有效稅率	39.12%	49.38%	23.48%		
淨利率	3.54%	0.77%	4.36%		

# 營收 & 毛利率

(百萬 NTD)



■ 消費性電子
 ■ 基礎建設
 ■ 智慧型手機
 ■ 汽車電子



3Q23 產品成長率	QoQ	YoY
汽車電子	+22.4%	+23.1%
智慧型手機	+22.4%	-10.3%
基礎建設	+24.4%	+8.2%
消費性電子	+14.2%	-18.6%



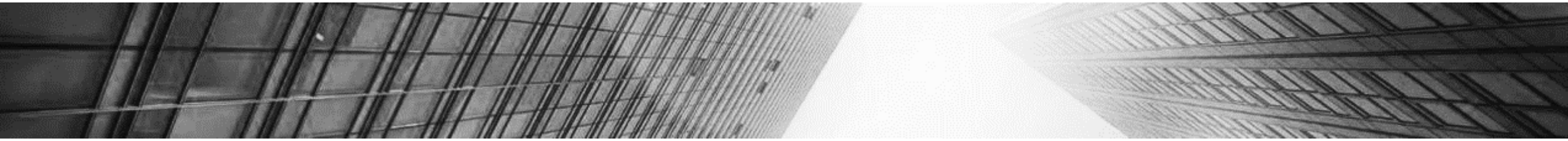
NTD/百萬元	3Q23	2Q23	3Q22
<b>資產總額</b>	<b>33,881</b>	<b>30,905</b>	<b>32,523</b>
現金及約當現金	6,030	4,692	4,310
應收帳款/票據	11,470	10,365	12,315
存貨	2,834	2,422	2,579
固定資產/預付設備款	11,387	11,049	<b>11,166</b>
<b>負債總額</b>	<b>14,126</b>	<b>12,189</b>	<b>12,525</b>
短期借款	2,554	1,544	3,521
應付帳款/票據	6,332	4,590	3,954
長期借款	2,600	2,559	1,477
<b>股東權益總額</b>	<b>19,755</b>	<b>18,716</b>	<b>19,998</b>
<b>重要財務指標</b>			
應收帳款週轉天數	171	165	154
存貨週轉天數	52	49	60
應付帳款週轉天數	102	88	77
股東權益報酬率(年化)(%)	3.43	3.74	11.30
資產報酬率(%)	2.33	2.55	6.99
負債比(%)	41.69	39.44	38.50

年度	每股盈餘(NT\$)	股利(NT\$)	現金股利(NT\$)	配息率(%)
2016	3.13	2.5	2.5	80%
2017	4.11	3.1	3.1	75%
2018	5.86	3.8	3.8	65%
2019	8.13	5.0	5.0	62%
2020	8.19	5.0	5.0	61%
2021	9.00	5.0	5.0	56%
2022	4.94	3.0	3.0	61%

\*於2020年3月31日完成現金增資發行新股3千萬股

\*\*於2021年9月2日完成現金增資發行新股5千萬股

\*\*\*計入3Q22庫藏股買回與註銷2千萬股；目前普通股數約為3.63億股



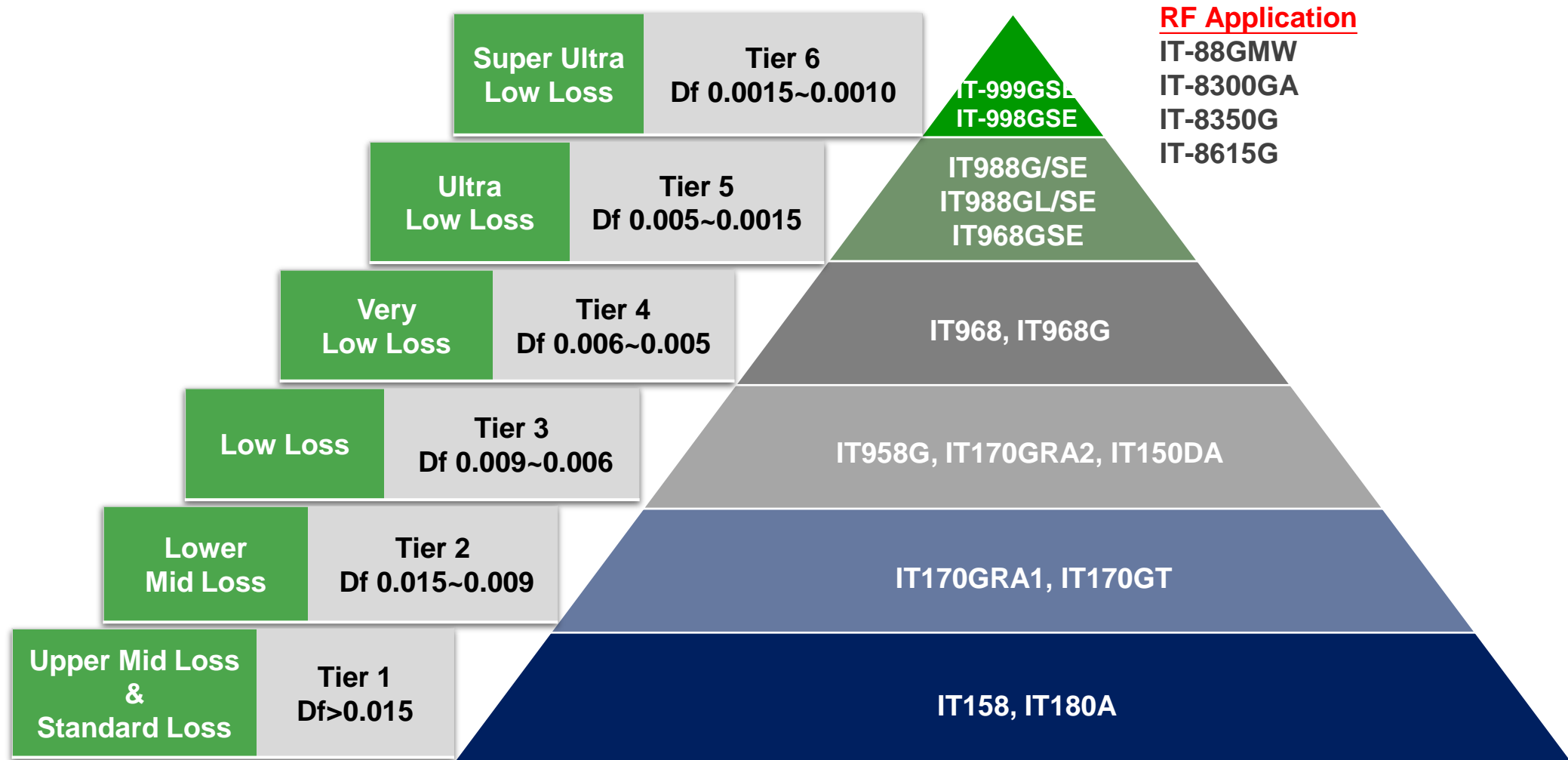
# 成長策略藍圖

---

**ITEQ**

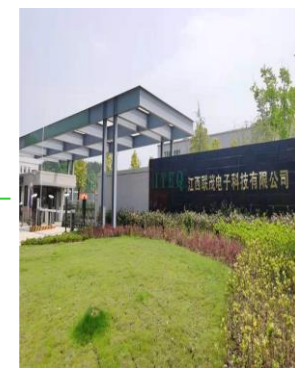
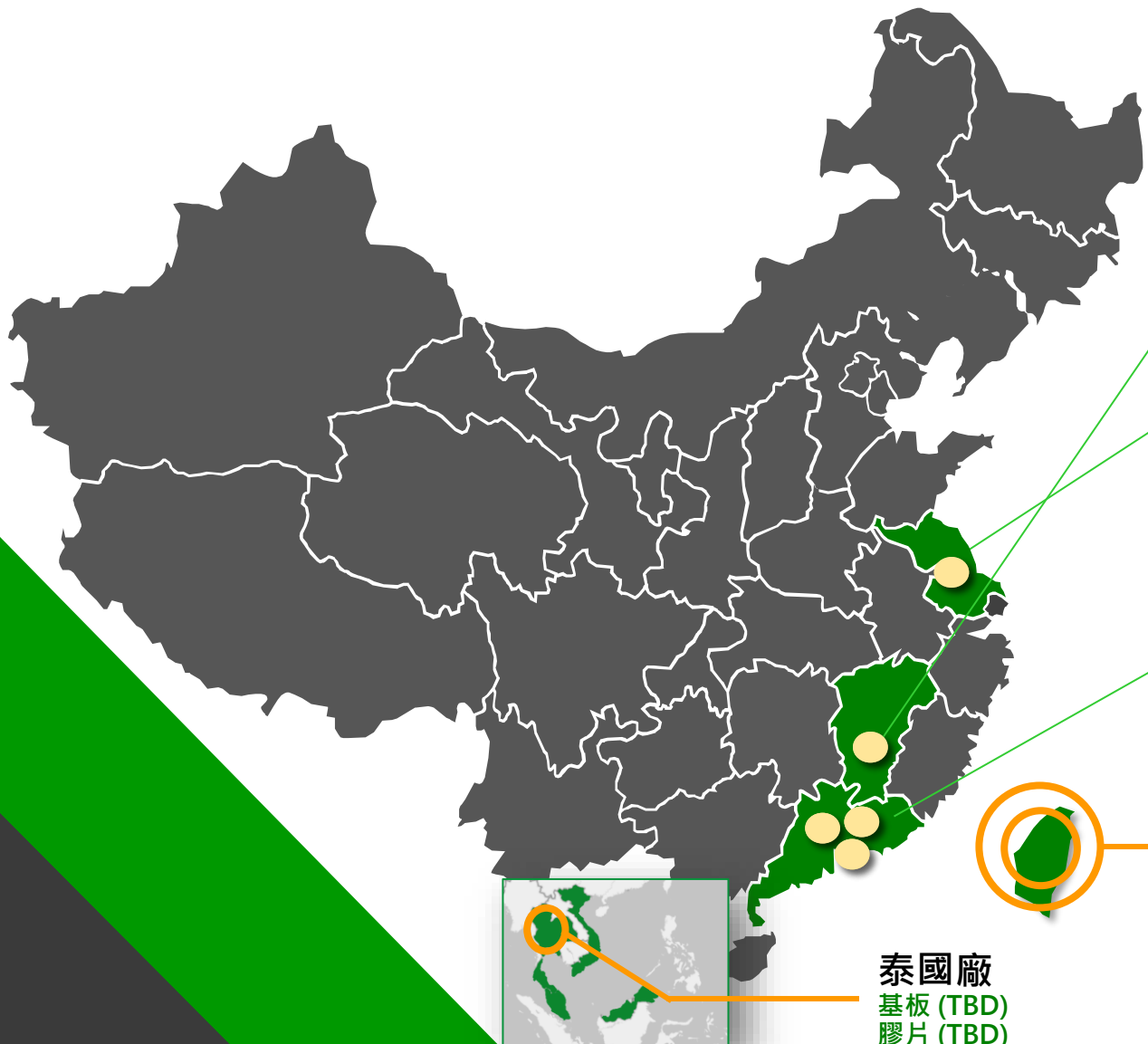
**ITEQ**

INNOVATION • TEAMWORK •  
EXCELLENCE • QUALITY



- 隨著高速運算資料中心、伺服器升級等需求，帶動高頻高速材料需求高度成長。
- ITEQ在高頻高速材料市場的市占率將顯著提升。

# 廠區分布與產能 – 江西 & 泰國廠規劃



**江西廠**  
(第一期) - 2020  
基板 (60萬張/月)  
膠片 (350萬米/月)  
(第二期) - 2021  
基板 (60萬張/月)  
膠片 (350萬米/月)  
(第三期) - 2022 & 2023  
基板 (120萬張/月)  
膠片 (500萬米/月)



**無錫廠**  
基板 (165萬張/月)  
膠片 (800萬米/月)



**東莞廠**  
基板 (100萬張/月)  
膠片 (400萬米/月)



**廣州廠**  
軟板 (145萬平方米/月)



**黃江廠**  
壓合代工 (50萬平方呎/月)

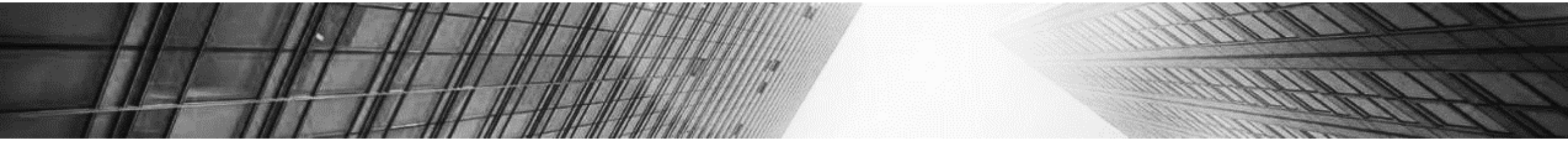


**台灣新竹廠 (總部)**  
基板 (40萬張/月)  
膠片 (240萬米/月)

**泰國廠**  
基板 (TBD)  
膠片 (TBD)

Distributor/Agent: USA, Europe, Israel, Korea, Japan and Singapore





# 市場趨勢 & 成長動能

---

**ITEQ**

AI伺服器CPU\*2主板  
(產值-中)

(Used in both general type server and AI server)  
**CPU主板**

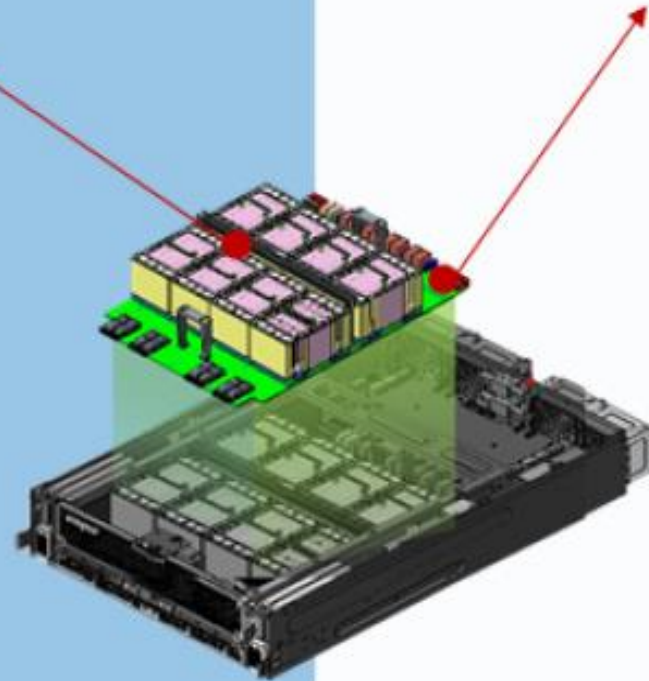


CCL : Very Low Loss 材料  
板層數 : 14~24層

AI伺服器GPU OAM加速卡\*8  
(產值-最高)

(Used in accelerator card- AI server only)

**GPU Tray**



CCL : Ultra Low Loss 材料  
板層數 : 20~30層 (HDI)

AI伺服器GPU UBB底板  
(產值-高)

(Used as GPU board- AI server only)

CCL : ULL / VLL 材料  
板層數 : 20~30層 (含HDI)

# 資料中心伺服器平台持續升級

Intel	Platform	Purley		Whitley	Eagle Stream		Birch Stream
	CPU	Skylake	Cascade Lake	Ice lake	Sapphire Rapids	Emerald Rapids	Granite Rapids
	Nano Process	14 nm	14 nm+	10 nm	Intel 7	Intel 7	Intel 3
	PCIe Gen	PCIe 3.0	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2021 Q1	2023 H1	2023 H2	2024
	CCL Material	Mid Loss	Mid Loss	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss	VLL/ Ultra Low Loss
	Layer count	8 to 12	8 to 12	12 to 16	16 to 20	16 to 20	TBD



AMD	Architecture	Zen	Zen2	Zen3	Zen4		Zen5
	CPU	Naples	Rome	Milan	Genoa	Bergamo	Turin
	Nano Process	14 nm (Global Foundries)	7 nm (TSMC)	7 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)	5 nm (TSMC)	4 nm / 3 nm (TSMC)
	PCIe Gen	PCIe 3.0	PCIe 4.0	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0
	MP Time	2017 Q3	2019 Q3	2020 Q4	2022 Q4	2023	2024
	CCL Material	Mid Loss	Low Loss	Low Loss	Very Low Loss	Very Low Loss	VLL/ Ultra Low Loss
	Layer count	8 to 12	12 to 16	12 to 16	16 to 20	16 to 20	TBD

資料中心長期穩定升級將有利予以下；

- 對應設備之基板材料亦同等升規
- 增加銅箔基板消耗量與設計板層數

## 綠能/電動車



- 節能
- 大電流
- 充電
- 大電壓
- 厚銅

High Tg 材料

## 車聯網

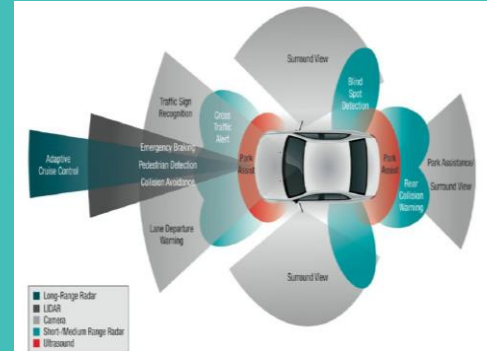


- 車用資訊娛樂
- 網路通訊

HDI 材料

高速材料

## 主動式安全系統



- 安全駕駛系統
- ADAS (先進駕駛輔助系統)
- 雷達
- 天線模組

高頻材料

高速材料

## 自動駕駛



- 車用高速運算
- 影像處理計算
- 自主駕駛控制平台模組

HDI 材料

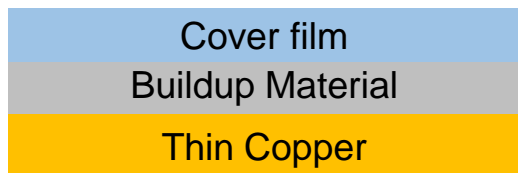
高速材料

- 電動車、車聯網和主動式安全駕駛系統將推動高性能車用銅箔基板之需求
- 電動車用PCB為傳統燃油車的四至五倍

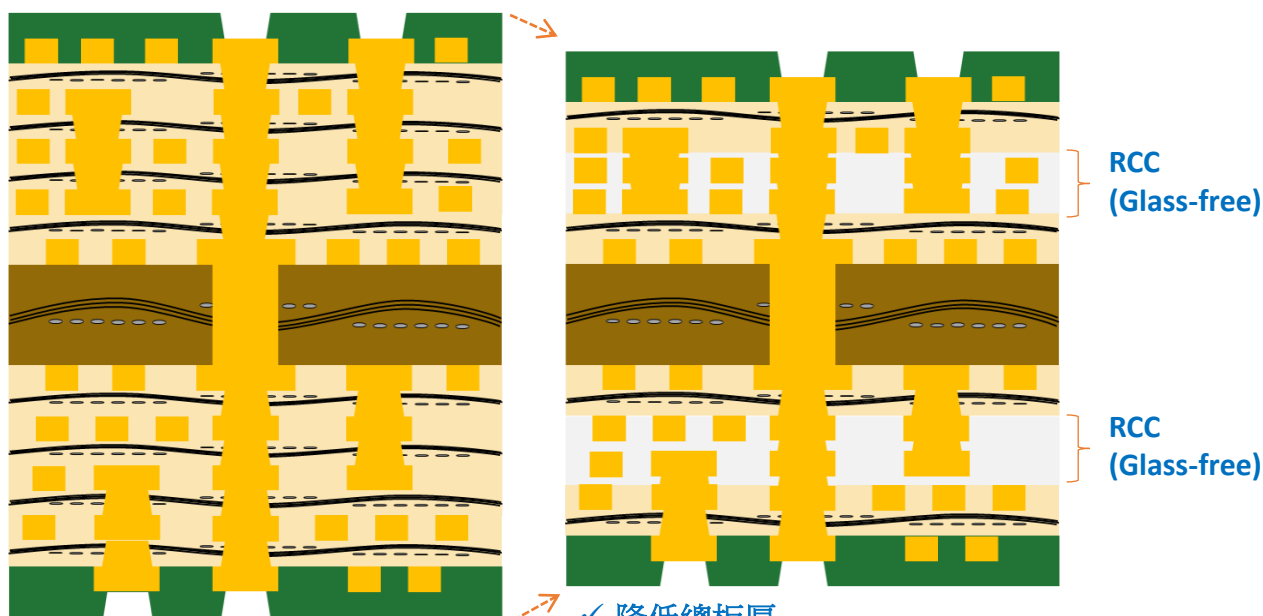
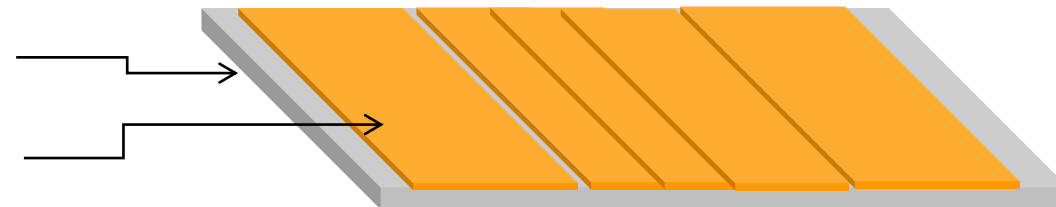


## 背膠銅箔 (RCC)

- ✓ 無玻纖布有效降低介電層厚度亦同時滿足細線路設計 (smaller form factor) 和hybrid HDI/類載板製程需求



介電層：10~50um  
※ Available for thickness up to 150um  
導體：Copper Foil



- ✓ 降低總板厚
- ✓ 排除玻纖效應 (fiber weave effect)  
強化信號傳輸可靠性

## 產品優勢

### 無玻纖布 (Glass-Free)

降低總板層厚度，克服最小厚度限制 (15-20um)

### 介電常數 (Dk) 及阻抗控制較佳

RCC使用純膠材料，可維持穩定介電常數

### 節省電力耗損

低電壓 - 延長電池壽命

### 雷射加工性較佳

RCC為無玻纖布材料，雷射鑽孔較容易成孔，且孔型品質穩定

### 簡化PCB疊合製程

膠片/銅箔增層的兩道製程合併為一道





Thank you

Question and Comment